

# TACFlux® 026

## 特点

- 出色的润湿性能
- 回流温度范围宽
- 免洗
- 残留低

## 简介

**TACFlux® 026** 是专门为倒装芯片和芯片级封装 (CSP) 焊接设计的免洗无卤助焊剂。该产品还可被用于3D封装 (POP叠层封装)。**TACFlux® 026**可配合范围很宽的回流温度,且适用于所有锡铅、无铅和高铅工艺。

## 特性

TACFlux® 026储存在0-30°C环境中时	
助焊剂等级	ROLO
典型粘度	330kcps
典型酸性值	34
典型粘着强度	240g
回流环境	氮气
表面绝缘电阻(SIR)	合格
清洁	免洗
典型回流残留物重量	5%

## 应用

**TACFlux® 026** 可用印刷、滴涂、针转移或者浸渍等方式涂覆。

## 清洁

**TACFlux® 026** 专门为免洗应用设计。如需要,可用不完全水洗系统、皂液、酒精或者其他不含氟氯碳 (CFC) 的清洁剂清洗。

## 包装

**TACFlux® 026** 提供150g SEMCO筒装、10cc和30cc的注射器包装以及100g罐装。也可应求提供其他包装。



## 储存与操作

**TACFlux® 026** 储存在0-30°C下,其保质期为6个月。使用前应确保助焊剂达到操作环境的温度。包装上也应注明开封时间和日期。

## 安全说明书

本产品的安全说明书可从网站上获取:  
<http://www.indium.com/sds>

本产品说明书仅供参考,并不对所描述的性能做任何担保。具体质保信息请参见产品合同、发票或者发货单里的文字说明。除特别说明,钢泰公司的产品和解决方案均市场有售。

表格编号: 98202 (SC A4) R1

[www.indium.com](http://www.indium.com)

[china@indium.com](mailto:china@indium.com)

亚洲: 新加坡、韩国清州、马来西亚: +65 6268 8678  
中国: 苏州、深圳: +86 (0)512 628 34900  
欧洲: Milton Keynes, Torino: +44 (0) 1908 580400  
美国: Utica, Clinton, Chicago, Rome: +1 315 853 4900



©2017 Indium Corporation

经  
ISO 9001  
注册